

## 社長インタビュー

**Q 今後5年間のマーケットの姿をどのようにとらえていますか。**

IT革命が進行する中、大容量データを送受信することが可能なブロードバンド(広域帯通信網)化がいよいよ始まります。これにより、今までよりも臨場感あふれる映像や音声が大変なスピードで伝達されるようになります。ブロードバンド化によりデジタル家電といわれるものを含めて、さまざまな製品が世の中に出てくることになるでしょう。これはすなわち、高度な半導体チップやLCDパネルが大量に必要な時代が来るということです。半導体・LCD産業、さらにそれを支える製造装置産業は、短期的には下降局面があるとしても、中長期的には2桁の伸びを示していくと思います。そういう意味では非常に夢のある市場です。

**Q そのような中で、東京エレクトロンはどのような強みを発揮し、成長軌道を描いていくのでしょうか。**

東京エレクトロンはまさに、これらの高度な半導体とLCDを製造する装置を提供しています。そればかりでなく、コンピュータ・ネットワーク部門、電子部品部門では専門商社として、インターネット、モバイル関連の世界に優れたシステムや半導体チップを販売しています。つまり、当社のどの事業部門もIT革命のファンダメンタルな分野に参入しているのです。それぞれの分野でトップシェアを維持、あるいは獲得していくことでさらなる成長を図っていきます。

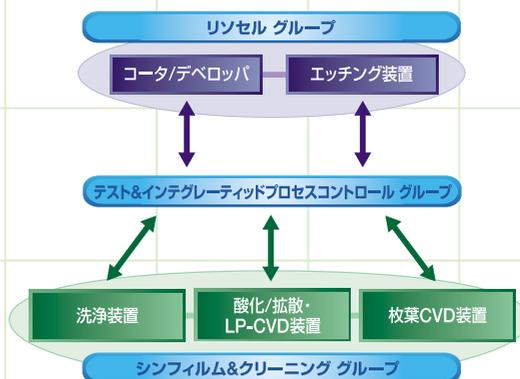
これからの半導体製造装置ビジネスは、装置メーカーにプロセスインテグレーションの能力があるかどうか鍵になります。隣り合う幾つかのプロセスに対して自社の複数の装置で一連のソリューションを提供していくやりかたです。これは当社のように幅広い製品ラインナップがあって初めて可能となるもので、これができる企業は世界でも限られています。

また、このプロセスインテグレーションにさらに高い付加価値を与えるものが、最先端プロセス制御技術、アドバンスプロセスコントロール(APC)といわれるものです。私たちのお客さまである半導体メーカーは常に製造ラインの歩留りを管理しています。もし、装置内部に、あるいは装置間にプロセス制御機能が備わっていれば、お客さまの安定的高歩留りの達成を強力にサポートすることができます。このプロセス制御技術を提供できるかどうか、今後大きな差別化のポイントになっていくはずで、これができる企業も世界的に見て数少ないのです。当社は今後、この分野にも力を入れていくことで、さらに売上を伸ばしていくつもりです。



**Q この4月に行った組織改革には、そうした東京エレクトロンの目指すビジネス展開がどのように反映されているのでしょうか。**

これまで半導体製造装置部門は、製品別のビジネスユニットを中心に構成されていました。今度の改革では、LCD製造装置分野を除いた部分を大きく3つのグループに再編しました。リソセルグループ、テスト&インテグレイティッドプロセスコントロールグループ、シンフィルム&クリーニンググループの3つです。今回の組織改革には2つの大きな意義があります。1つは、今後強化すべき当社の装置ビジネスのコアコンピタンスが何であるかを明確にしたこと。2つめは、高い付加価値を持つプロセスインテグレーション、これは戦略的に大変重要なものなのですが、これを具体的に実行していく母体を明確にしたことです。



**Q 半導体産業におけるメガトレンドの1つ、300ミリウェーハ用生産ラインの導入が一部のお客さまで始まっていますが、東京エレクトロンの300ミリ装置の状況はいかがですか。**



現在、世界的な設備投資縮小の影響を受けて、200ミリウェーハ用装置市場は縮小しています。しかし当社の300ミリウェーハ用装置の受注は好調です。すでにすべての300ミリモデルが出そろっており、半導体製造装置部門の受注全体に占める300ミリ装置の割合は20%近くに達しています。この1年間でさらに比率は高くなります。受注獲得の大きな力となっているのが、お客さまの300ミリ移行に対する当社の抜群のサポート体制です。山梨県韮崎市にある新プロセステクノロジーセンターは世界で最大の300ミリ装置の評価ラボであり、300ミリ工場のコンセプトが具現化

されている先進の施設です。ここでは、お客さまが個々に抱える300ミリ製造技術の課題をお客さまと一緒に解決していきます。300ミリへの移行は当社製品の市場シェアをさらに高める絶好の機会ととらえています。

**Q 新しい技術分野に進出しトップに立つためには、関連技術の買収も必要になってくるのではないのでしょうか。**

新規技術を獲得する方法は3つ考えられます。まず、自社による開発です。しかし、当社のコア技術に深く関わる重要な技術で、他社の技術を獲得した方が早い場合は、買収を考えます。もう1つは、他企業との戦略的提携で、当社のコア技術を補完する技術の場合はこの方法を選択できます。昨年、革新的な銅配線メッキ技術を持つ米国NuTool社とパートナーシップを結びましたが、これなどはそのいい例です。



**Q 半導体製造装置産業はアップダウンの激しい産業といわれますが、東京エレクトロンはこれをどのように乗り越えてさらなる成長を遂げようとしているのですか。**

今後もこのサイクルは必ずあると思います。であるからこそ、サイクルに対処できる非常に高効率で柔軟な企業体質を作ることが必須の条件になるのです。当社では、受注から製品完成までのリードタイムを2年後には半分にするプロジェクトを現在進めています。今回のダウンサイクルには間に合いませんでしたが、これが完成すれば資産効率の高い体質が構築されるはずです。

これまで当社は厳しい環境を利用して成長してきました。事実、装置市場がアップダウンを繰り返す中で、技術や経営上の課題を克服した企業が大きく伸びてきましたし、また半導体産業もそうして発展してきました。厳しい環境こそが革新を生むのです。これまで主流だった技術が古くなり、新しい技術がそれにとって代って主流になります。このような変化の時期に、当社は積極的に技術の革新、マネジメントの刷新を図るのです。

この厳しい環境から抜け出すときには間違いなく300ミリ装置が主流になるでしょうし、システムLSIのような少量多品種デバイスを効率良く作る装置への需要も高くなると予想しています。当社は300ミリ装置のブラッシュアップを進めるとともに、製造サイクルタイムを大幅に短縮化する新しいコンセプトの装置である、新高速熱処理炉TELFORMULA™や300ミリエッチャーTELIUS™といった装置の市場投入も強力に進めていきます。この厳しい時期にも研究開発投資を緩めるつもりはありません。

## Q コンピュータ・ネットワーク部門、電子部品部門の今後の展開をお聞かせください。

どちらも引き続き高成長分野にフォーカスしていきます。コンピュータ・ネットワーク部門では、ブロードバンド時代のコア技術となるストレージエリアネットワークやインターネット技術関連商品を、電子部品部門では、通信関連デバイスやシステムLSIなど付加価値の高い商品を充実させます。この分野では単なる商社ではなく、極めて高い専門技術を持った技術集団としてお客さまの高い評価をいただいています。これらの部門に蓄積されているエンジニアリング機能や設計機能を今後さらに強化していけば、面白いビジネスが展開できるはずです。

## Q 経営上の次の課題はどのようなものでしょうか。

いろいろやりたいことはありますが、当社が一層発展していくためには、真にグローバル化された企業になる必要があると考えるようになりました。ここ数年間進めてきたグローバル化は、今日の当社の収益拡大に大きな貢献をしています。ただ、これまでのグローバリゼーションは、拠点拡大を中心とした日本から世界へと広がるグローバリゼーションでした。これからはむしろ求心的な方向、つまり、世界の強さを当社の経営により多く取り込んで行く方向性が必要だと考えています。例えば、本社機能の一部を海外に移すことなども、可能性がある話かもしれません。当社のグローバリゼーションのフェーズⅡの具体的な構想を練る時期に来ています。また、今後大きな市場となる中国を含む東南アジアでのサポート体制も拡充していかなければなりません。



最近、当社は世界のトップクラスのお客さまから当社の製品とそれに対するサービスサポートが大変優れていると評価され、いろいろな賞を頂くようになりました。お客さまも当社に対して、エールを送ってくれているのだと思います。これを励みに、今後も、高い企業価値をもつ真のグローバルカンパニーを目指して努力してまいります。